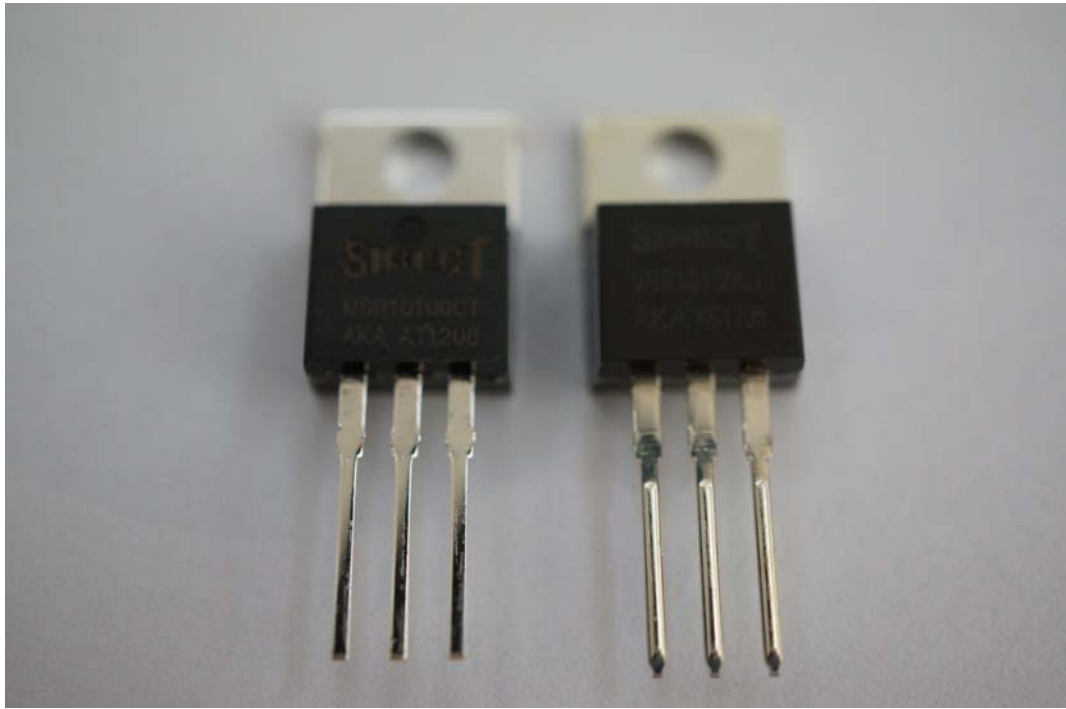


Process Change Intend Notification (PCIN)

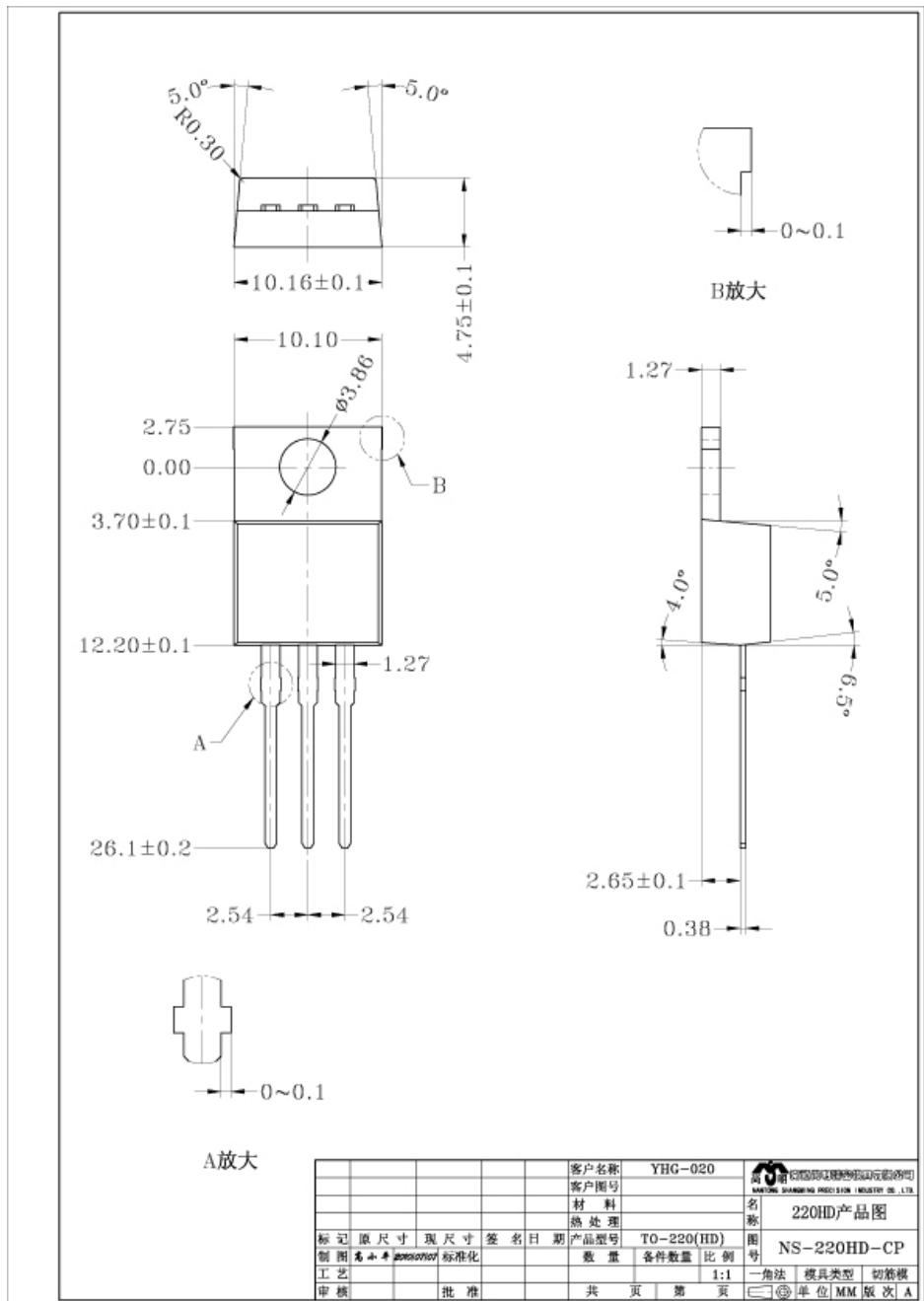
PCIN NO.: PCIN-SR-2012-001

Date: 2012.5.1

Customer: All
Package type affected: TO-220AB & TO220AC (ATxxxx Date code)
Process step affected: NA
Manufacturing site affected: NA
Proposed change: TO-220 有鹵環保料 AT 模具整改修繕，同時啓用 HG 新模具
Reason for change: 因 TO-220 舊有模具 AT 系列使用時間已久，需要大幅整改修繕，並同時解決改善過去塑封料吸濕容易導致漏電(IR)升高以及其他問題，除舊有 AT 模具送廠修繕外，亦同時啓用新改良模具 HG 系列。新模具 HG 規格尺寸如下，明顯差異為塑封料正面無圓形脫模孔，背面黑膠部位嵌入銅框架較多(為解決模料吸濕問題)，主要為外觀差異，晶圓規格與製程沒有改變，電器特性沒有影響。
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>圖一、AT 模具(左)與 HG 模具(右)正面外觀</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>圖二、AT 模具(左)與 HG 模具(右)背面外觀</p> </div> </div>



圖三、AT 模具(左)與 HG 模具(右整體)外觀比較



圖四、HG 模具實際尺寸工程圖

Estimated date of implementation: 於 2012.5.1 開始執行

MFG Department: Allen Chen Date: 2012.5.1

PE Department: Leo Lin Date: 2012.5.1

QA Department: James Chen Date: 2012.5.1

Customer Approval: _____ Date: _____

Initiator: rene 2012.5.1

Approver by: [Signature] 2012.5.1